

Manz AG: Strategische Kooperation im Bereich Mikroelektronik eröffnet neue Perspektiven in attraktivem Zukunftsfeld

- *Neuer Trend im Verpacken von Mikrochips: Fan-Out Panel Level Packaging wird mit nasschemischer Produktionstechnologie von Manz realisiert*
- *Strategische Partnerschaft sichert Zugang zur leistungsstarken Zukunftstechnologie*
- *Ersten Auftrag im Volumen von über 5 Mio. Euro von Kooperationspartnern erhalten*

Reutlingen, 28. Juni 2018 – Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat im Bereich Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP) eine strategische Kooperation mit PEP Innovation PTE Ltd, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Singapur, und einem der einflussreichsten Unternehmen Chinas in der Mikroelektronik gestartet. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung dieser leistungsstarken Zukunftstechnologie in der Verpackung von Mikrochips. Im Rahmen der Kooperation erhielt die Manz AG einen ersten Auftrag durch ein von den Kooperationspartnern gegründetes Joint Venture im Volumen von über 5 Mio. Euro.

Mikrochips werden auf Basis von Siliziumwafern hergestellt, auf welche die Chiphersteller mittels Fotolithografie das Layout des Schaltkreises übertragen. Die Chips werden im Anschluss an den Fertigungsprozess zum Schutz und zur einfacheren Kontaktierung mit einer Epoxidverbindung verkapselt. Man spricht vom sogenannten Packaging. Zur Realisierung der zunehmenden Miniaturisierung, d. h. immer kleinere Bauteile mit immer größerer Leistungsfähigkeit, kommt dem neuesten Packaging-Verfahren, dem Fan-Out Panel Level Packaging, eine entscheidende Rolle zu. Neben einer deutlichen Reduktion von Volumen, Dicke, Gewicht und Herstellkosten des Packagings bei gleichzeitiger Verdopplung der Anzahl der Pins, hat der Prozess auch signifikant positive Auswirkungen auf die thermische Leitfähigkeit und Geschwindigkeit der Bauteile.

Mikrosysteme mit diesen Eigenschaften bilden damit die Grundlage der rasanten Digitalisierung in vielfältigen Bereichen unsers Lebens. So hat sich die Anzahl der verbauten Chips zum Beispiel in Smartphones in den letzten 10 Jahren mehr als verzehnfacht. Auch in der Automobilindustrie werden die Megatrends Elektromobilität und autonomes Fahren zusätzlich zu den bereits heute verbauten Fahrassistenzsystemen zu einem sprunghaften Anstieg der verbauten Chips führen. So rechnet der global tätige Industrieverband der Elektronikindustrie SEMI mit einer Steigerung von aktuell 60 bis 100 Sensoren pro Auto auf über 200 Sensoren im Jahr 2020.

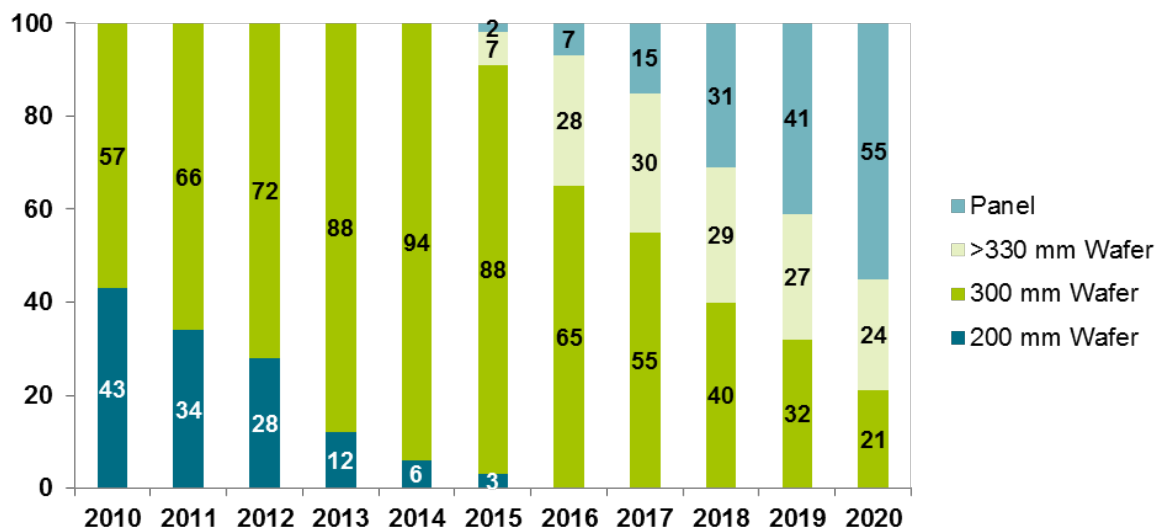
Eckhard Hörner-Marass, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: „Mit dem Eintritt in den Markt für Fan-Out Panel Level Packaging sichern wir uns als Hightech-Maschinenbauer den Zugang zu einem absoluten Zukunftsfeld in der Mikroelektronik. Im Halbleitermarkt zeichnet sich aufgrund der Kosten- und Produktivitätsvorteile ein Trend hin zur Fertigung rechteckiger Panelformate in Form des FOPLP ab. Als Spezialist in der

Leiterplatten- und Display-Produktion verfügen wir über das nötige technologische Know-how, um im Zuge der Kooperation mit unseren strategischen Partnern als weltweit erster Ausrüster eine voll integrierte und automatisierte FOPLP-Produktionslösung aufzubauen. Zudem bestätigt sich mit diesem Projekt die Anfang des Jahres vorgenommene Zusammenführung der beiden Geschäftseinheiten Display und PCB, da beim FOPLP Herstellungsprozess ein enges Zusammenspiel der prozesstechnischen Kompetenzen beider Bereiche unabdingbar ist.“

Robert Lin, Geschäftsbereichsleiter Display und PCB und Geschäftsführer der Manz Taiwan Ltd. ergänzt: „Mit mehr als 7.500 installierten Anlagen und rund 30 Jahren Erfahrung ist Manz in Taiwan und China Marktführer im Bereich nasschemischer Prozesse für die Herstellung von Leiterplatten sowie Displays und Touchpanels verschiedener Substratgrößen. Die dafür entwickelte Prozesstechnologie kommt nun beim FOPLP-Verfahren zum Einsatz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern und werden unseren Beitrag dazu leisten, als Pionier in diesem Wachstumsmarkt FOPLP in die Massenproduktion zu überführen.“

Entwicklung der Substrattypen für Fan-Out Packaging bis 2020 (in %)

Quelle: Yole 2015



Unternehmensprofil:

Manz AG – passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit führender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in fünf Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen „Electronics“, „Solar“ und „Energy Storage“ eingesetzt und weiterentwickelt.

Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Die Manz AG beschäftigt aktuell rund 1.700 Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Asien. Mit dem Claim „passion for efficiency – Effizienz durch Leidenschaft“ gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel.: +49 (0)611 – 205855-28
Fax: +49 (0)611 – 205855-66
E-Mail: krause@cometis.de

Manz AG
Axel Bartmann
Tel.: +49 (0)7121 – 9000-395
Fax: +49 (0)7121 – 9000-99
E-Mail: abartmann@manz.com

Folgen Sie uns auf:

